

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11) 実用新案出願公開番号

実開平4-94732

(43) 公開日 平成4年(1992)8月17日

(51) Int.Cl.<sup>4</sup>

H 0 1 L 21/60

識別記号

3 1 1 S 6918-4M

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全 3 頁)

(21) 出願番号 実願平3-493

(22) 出願日 平成3年(1991)1月11日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 考案者 木村 誠

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ

株式会社内

(72) 考案者 川口 久雄

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ

株式会社内

(72) 考案者 西村 明男

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ

株式会社内

(74) 代理人 弁理士 梅田 勝

(54) 【考案の名称】 半導体素子の基板への接続構造

(57) 【要約】

【目的】 半導体素子を複数のバンパを介して基板にフェイスダウンボンディングする半導体素子の基板への接続構造において、複数のバンパの形状を小さくしてチップ上のバンパ数を増やす場合に、半導体素子及び基板間の接合強度が低下することを防止する。

【構成】 半導体素子1及び基板2の接続面の4隅に、バンパ3より大きなダミーのバンパ5を設ける。半導体素子1及び基板2の接続面の4隅近傍のバンパ7を他のバンパ3より大きくする。

【効果】 半導体素子及び基板の接続面の面積を従来より大きくすることなく、接合強度を向上できる。

